让尖端科技融入日常生活

SEKISUI
积水化学 给你惊喜

薄膜表面处理用滚轴直接型等离子体装置

RD

实现高度均一性与薄膜零损伤
（不产生粒子）

特点/装置规格

1 » 辉光放电处理
实现高度均一性与薄膜零损伤（不产生粒子）

2 » 高超的处理性能
在100m/min以上的速度下也有实绩

3 » 丰富的产品阵容
拥有高达2500mm幅面的实绩，1头型或3头型

4 » 无需真空的常压工序
便于加装到原有生产线上

支持宽度	处理速度	实用
~2500mm	~100m/min	电源、处理气体(N2、CDA)、排气、冷却水

薄膜表面处理用滚轴直接型等离子体装置

RD

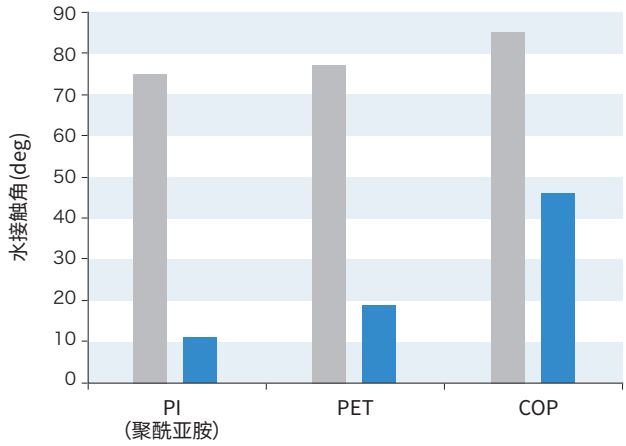
用途

领 域	使用目的
光学薄膜领域 （偏光板等）	用于功能膜涂层的预处理， ①提高涂层膜的密着性 ②帮助形成更薄的涂层
PI、CCL	对PI薄膜进行处理，提高其与粘合剂及其他薄膜的密着性
其他薄膜	・PET、PP、PE等各类薄膜的印刷预处理 ・氟类薄膜等的润湿性改善等

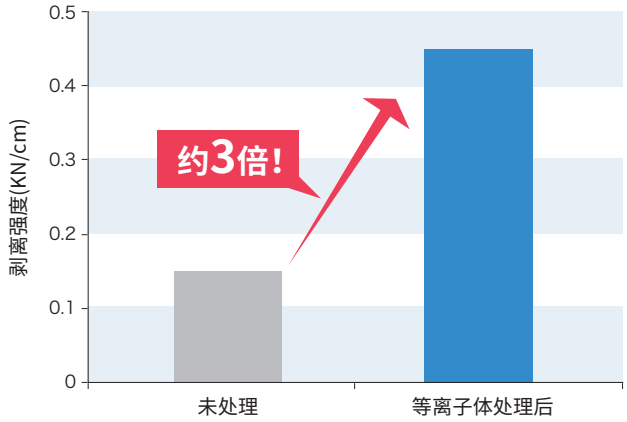
基本处理性能

▶各类薄膜的接触角数据

■ 未处理
■ 等离子体处理后
※处理速度：30m/min



▶与聚酰亚胺及环氧树脂类粘合剂的粘合强度



积水化学工业株式会社
P2事业推进部

邮编601-8105 京都市南区上鸟羽上调子町2-2 Tel: 075 (662) 8621 Fax: 075 (662) 8940
http://www.sekisui-semi.jp

more. AP.